

スマートフォン用Board to Boardコネクタ FB35AT5シリーズの紹介

今や私達の生活に欠かせないスマートフォン等のモバイル機器は、多機能化が進むにつれ、搭載されるモジュール数も増加しています。それに伴い、機器内部の高密度化も必要不可欠となっているため、コネクタにおいては、さらなる小型化・軽量化が求められています。

このような市場ニーズを背景に、当社は小型化を追求した嵌合高さ0.5mmの超小型Board to Boardコネクタを開発しました。

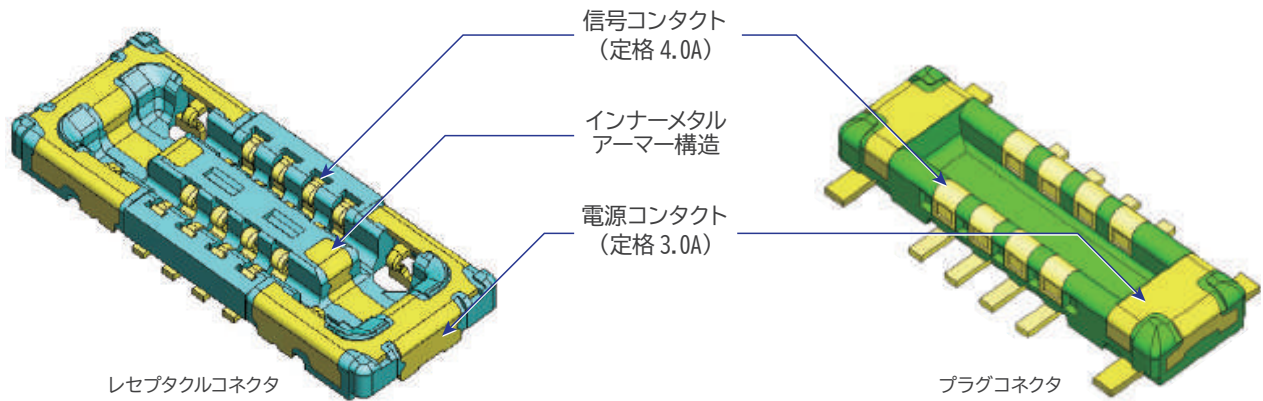
定格電流0.4 Aの信号コンタクトに加え、定格電流3Aの電源コンタクト2端子を配置(図1)しています。

電源コンタクトは大電流対応だけでなく、コネクタを補強する役割も兼ね備えており、嵌合時の破損を防止します。

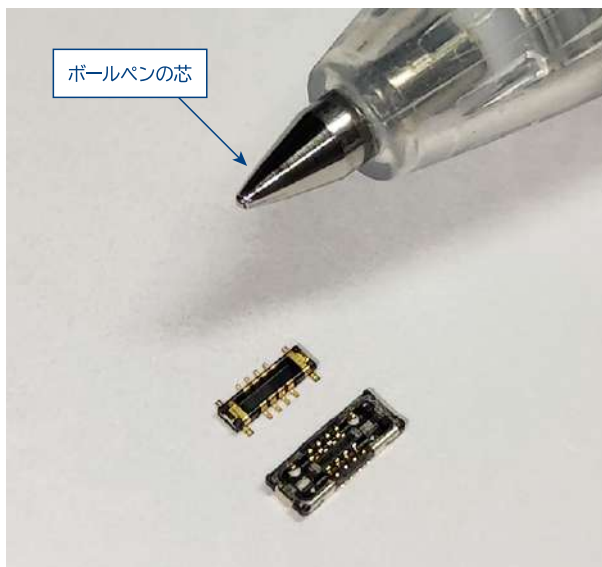
また、コネクタの更なる強度アップを実現する為に“インナーメタルアーマー構造*”を採用しています。

*インナーメタルアーマー構造：レセプタクルコネクタ中央部に金属を配置

■ 図1 コネクタ外観図



■ 図2 外観



■ 表1 仕様

	現行品	新製品
シリーズ	FB35AT6	FB35AT5
嵌合高さ	0.6 mm	0.5 mm
ピッチ	0.35 mm	
幅	1.65 mm	
定格電圧	AC 30 V (r.m.s.) / DC 30 V	
定格電流	信号コンタクト : 0.4 A / pin 電源コンタクト : 3.0 A / pin	
耐電圧	AC 200 V(r.m.s.) / 1分間	
絶縁抵抗	DC 200V 100MΩ以上	
接触抵抗	信号コンタクト : 30 mΩ以下 電源コンタクト : 20 mΩ以下	
使用温度範囲	- 40℃ ~ + 85℃	
芯数	信号コンタクト : 8,10,18	信号コンタクト : 8
	電源コンタクト : 2	

■SDGs 17目標に該当するポイント

年々、多機能化が進むスマートフォン等のモバイル機器に対し、さらなる小型化・軽量化を追求したコネクタを開発することで、その発展に貢献します。

